

公司概況資料表

以下資料由宇川精材公司及其推薦證券商提供，資料若有錯誤、遺漏或虛偽不實，均由該公司及其推薦證券商負責。

以下揭露之認購價格及依據等資訊，係申請登錄興櫃公司與其推薦證券商依認購當時綜合考量各種因素後所議定。由於興櫃公司財務業務狀況及資本市場將隨時空而變動，投資人切勿以上開資訊作為投資判斷之唯一依據，務請特別注意

認購相關資訊

公司簡介

主要業務項目

最近五年度簡明損益表及申請年度截至最近月份止之自結損益表

最近五年度簡明資產負債表

最近三年度財務比率

公司名稱：宇川精密材料科技股份有限公司 (股票代號：7887)

董事長	郭文哲
總經理	郭文哲、陳建榮
資本額	817,200 千元
輔導推薦證券商	兆豐證券股份有限公司、元大證券股份有限公司、福邦證券股份有限公司、宏遠證券股份有限公司、富邦綜合證券股份有限公司
主辦輔導券商聯絡人電話	兆豐證券股份有限公司 吳小姐(02)2327-8988 分機 7998
註冊地國	非外國發行人，故不適用
訴訟及非訟代理人	非外國發行人，故不適用

輔導推薦證券商認購宇川精密材料科技股份有限公司股票之相關資訊					
證券商名稱	主辦	協辦	協辦	協辦	協辦
		兆豐證券股份有限公司	元大證券股份有限公司	福邦證券股份有限公司	宏遠證券股份有限公司
認購日期(註)	115 年 1 月 7 日				
認購股數 (股) (註)	1,100,000	200,000	100,000	100,000	100,000

修訂日期：114 年 12 月

認購占擬櫃檯買賣 股份總數之比率(註)	1.35%	0.24%	0.12%	0.12%	0.12%
認購價格(註)	每股新臺幣 76 元				
申請或登錄興櫃前 三個月認購之總股 數及占擬櫃檯買賣 股份總數之比率 (證券商認購創櫃 板階段之新股且計 入興櫃應認購股份 者適用)	無此情事				
認購價格之訂定 依據及方式	<p>本推薦證券商參酌一般市場認購價格訂定方式，評估市價法、成本法及現金流量折現法等評價方式，以推算合理之股票價格，作為本推薦證券商認購宇川精密材料科技股份有限公司(以下簡稱宇川精密或該公司)興櫃股票價格之訂定依據；再參酌該公司產業概況、經營績效、發行市場環境及同業市場狀況等因素後，由本推薦證券商與該公司共同議定之。</p> <p>基於目前股票價值的評估方法諸多種類，而各種方法皆有其優缺點，評估之結果亦有所差異，目前市場上常用之股票評價方法主要包括：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.市場基礎法：本益比法(Price/Earnings ratio, P/E ratio)或股價淨值比法(Price/Book value ratio, P/B ratio)，係透過已公開的資訊與整個市場、產業性質相近的同業與被評價公司歷史軌跡比較，作為評量企業的價值依據，再根據被評價公司本身異於採樣公司之部分作折溢價的調整。 2.成本法：係以帳面之歷史成本資料作為公司價值評定基礎的淨值法。 3.現金流量折現法：為採用未來現金流量作為公司價值之評定基礎。 <p>以上股票評價方法，成本法係以歷史成本為計算之基礎，易忽略通貨膨脹因素且無法反應資產實際之經濟價值，且深受財務報表所採行之會計原則與方法之影響，將可能低估成長型公司應有之價值；現金流量折現法下某些假設，如未來營收成長率、邊際利潤率、資本支出之假設等，因較難取得適切之數據，使未來現金流量及加權平均資金成本更無法精確掌握；另考量該公司目前仍屬虧損階段，故無法以本益比法評估該公司價值。因此，本次擬以市場基礎法之股價淨值比法評估該公司之興櫃認購價格。</p> <p>該公司積極投入先進半導體製程所需之金屬前驅物材料領域，綜觀目前國內上市公司，並無業務性質及產品種類與該公司相近之公司，綜合考量產業關聯性、產品相似性及營運模式後，選取鑫科（股票代號：3663）主要業務為各式薄膜濺鍍靶材及貴金屬材料之加工銷售、新應材（股票代號：4749）主要業務為其他化學製品製造及電子材料批發等及晶呈科技（股票代號：4768）主要業務精密</p>				

化學品之生產製造與銷售及特殊材料之銷售與代理等，選取以上三家同屬半導體產業鏈之公司為比較同業。

採樣同業	股價淨值比			
	114/09	114/10	114/11	平均
鑫科(3663)	3.39	3.04	2.65	3.03
新應材(4749)	9.38	9.53	8.43	9.11
晶呈科技(4768)	5.64	7.69	7.02	6.78
上櫃半導體業	3.46	3.68	3.50	3.55
上市半導體業	5.95	6.78	6.11	6.28

宇川精材之採樣同業及上市櫃半導體業類股 114 年 9 月份至 114 年 11 月份平均股價淨值比介於 3.03~9.11 倍之區間，該公司 114 年 6 月經會計師核閱之股權淨值為 371,898 千元，惟該公司於 114 年 8 月(經會計師出具 114 年第 2 季核閱財務報告日後)進行募資辦理現增 975,000 千元及發行轉換公司債 240,000 千元，為避免每股淨值失真，故以申請公發併送興櫃時股本 81,720 千股，及 114 年度 11 月自結自結報表股權淨值 1,626,547 千元，計算後每股淨值為 19.90 元，在排除極端值新應材後，股價淨值比區間介於 3.03~6.78 倍，設算認購價格區間為 60.30 元~134.92 元，另經參酌宇川精材經營績效、獲利情況、所處市場環境、產業未來成長性及同業績效，並考量總體經濟環境因素及興櫃市場流動性風險後，本次議定認購價格 76 元係於認購價格區間內，且為該公司之股價淨值比 3.82 倍，介於同業平均水準之股價淨值比間，故與宇川精材議定之認購價尚屬合理。

綜上，本次興櫃認購價格之訂定參酌股價淨值比法計算該公司之合理價格，並考量該公司經營績效、產業前景、發行市場環境、同業之市場狀況及流通性等因素後，由本推薦證券商與宇川精材共同議定興櫃股票認購價格為每股 76 元，尚屬合理。

註：輔導推薦證券商認購公司登錄創櫃板期間發行之新股，且計入其於興櫃應認購股份者，應依序敘明每次認購日期及其認購股數、認購價格。

公司簡介(公司介紹、歷史沿革、經營理念、未來展望等)

一、公司介紹：

宇川精密材料科技股份有限公司(以下簡稱宇川精材)成立於 100 年 3 月，總公司位於新竹縣竹北市，分公司及生產工廠位於南部科學園區，額定資本額為 2,500,000 千元，實收資本額為 817,200 千元。

宇川精材為專業有機金屬前驅物製造公司，在提供半導體先進製程前驅物已建立聲譽，是台灣專業生產高純度有機金屬前驅物及其他特殊化學品之製造公司。

二、歷史沿革：

日期	重要發展紀事
100 年 03 月	宇川化學股份有限公司成立，設立股本 8,000 千元。
100 年 08 月	進駐台南科工區「南台灣創新園區」。
101 年 10 月	金屬有機化合物合成/純化生產及實驗室分析儀器設備建置完成。
102 年 05 月	TMGa 產品量產成功與量產出貨。

修訂日期：114 年 12 月

103年07月	參加103年台南市「地方產業創新研發推動計畫」(地方型SBIR)「高純度金屬有機化合物量產技術開發」。
103年10月	TMAI、TMIn、TEGa等產品開發成功與量產出貨。
103年12月	CBr4產品開發成功與量產出貨。
104年01月	參加104年經濟部業界能源科技專案「次世代太陽能創新結構與關鍵材料國產化計畫」。
104年06月	DETe、DMZn、CBrCl3等產品開發成功與量產出貨。
104年08月	參加104年南科綠能低碳產業聚落推動計畫-高亮度藍光LED磊晶製成導入國產化TEG驗證。
104年09月	取得有機金屬化合物之製造方法專利證書(中華民國專利編號:發明第I499593號)。
105年04月	南科分公司廠房動土。
105年08月	更名為『宇川精密材料科技股份有限公司』。
106年11月	南科分公司廠房落成開幕。
107年01月	取得ISO 9001:2015品質管理系統認證及ISO 14001:2015環境管理系統認證。
108年09月	與聯華氣體工業(聯華林德)簽約合作,於台南廠區共同開發TSA生產設備及產線。
109年12月	TSA生產線建置完成,月產能可達300kg。
110年01月	取得ISO 45001:2018職業衛生安全管理系統認證。
110年03月	通過及執行經濟部工業局Å世代半導體計畫-半導體級原子層沉積前驅物開發計畫,成功試量產TSA並送業界驗證。
111年05月	通過南部科學園區新興科技應用計畫-次世代半導體技術氮化硼薄膜前驅物與原子層沉積製程之開發。
111年06月	超微量分析實驗室通過TAF認證(ISO 17025:2017)。
111年09月	首次參與SEMICON Taiwan半導體展。
112年01月	通過經濟部工業局Å世代半導體計畫-優先研發管制材料計畫,成功試量產DIS並送業界驗證。
112年09月	超微量分析實驗室TAF認證元素由9項擴增成31項。
113年06月	TSA產品獲得半導體客戶量產下單。
113年10月	南科管理局邀請協辦「複合式地震災害緊急應變演練」。
114年01月	通過114年度南部科學園區新興科技應用計畫,與儀科中心合作開發BN薄膜材料(第一年)。
114年06月	超微量分析實驗室TAF認證展期通過。
114年11月	於台南科學園區租賃廠房擴建R1廠鋼瓶自動清洗線。

三、經營理念：

宇川精材的核心價值是「誠信正直 Integrity、承諾 Commitment、創新 Innovation、客戶滿意 Customer Satisfaction」,秉持「顧客為尊、嚴格品管;持續改善、技術創新;遵守法規、風險防範;環境保護、節能減廢;健康安全、全員參與」的環安衛政策,落實「企業目標達成之際,就是個人成就實現之時」的群體創業信念,朝向「發展世界級先進半導體製程前驅物材料產業」為目標,為客戶開發新產品及技術。

四、未來展望：

1.短期發展計劃

主軸為穩定量產導入與在地韌性，具體發展目標包含：

- (1) 量產與良率：完成／維持核心客戶資格並穩定轉量產；以 SPC(統計製程管制)與微量金屬分析控管提升品質一致性，滿足客戶製程規格。
- (2) 交付韌性：建立「在地快速供應+跨線備援」機制，縮短交期、降低物流與地緣風險。
- (3) 廠內治理：公危品管理、職安衛與 ESG 資料揭露節奏與客戶稽核項目對齊；完成稽核缺點改善與持續改善。
- (4) 商務里程碑：以「樣品認證—小量導入—量產訂單」為節奏，設定月／季 KPI 追蹤達成率。

2.中期發展計劃

主軸為產品線深化暨策略聯盟擴張，具體發展目標包含：

- (1) 產品組合深化：針對下一代技術提前布局多款高純度前驅物與配套服務（如清洗再充填、鋼瓶資產管理、檢測分析），提高單一客戶材料滲透率。
- (2) 策略聯盟擴張：延續與國際夥伴的「共同開發／在地化量產」模式，引入關鍵合成／純化技術與全球供應資源；必要時與現有供應商聯手，提供差異化解決方案、避開正面價格戰。
- (3) 制度化創新：將「共研—試產—量產—分析檢測」標準流程內嵌，提升轉量產速度與可複製性；導入跨部門專案管理（P System Qualification 機制）。
- (4) 營運擴產：依客戶擴產節奏進行產能模組化擴充與設備佈建，確保供應穩定與成本優化。

3.長期發展計劃

主軸為在地生態系及區域化發展，具體發展目標包含：

- (1) 在地生態系：串聯上游原料、設備商與學研／政府資源，打造「研發—製造—檢測」在地生態，提升自給率與供應鏈韌性。
- (2) 區域化據點：以代工或協助實驗室分析方式提供在地化服務，與客戶全球擴產節奏同步。
- (3) 永續領航：加入核心公司供應鏈碳管理、能源管理與職安衛為差異化能力，支援核心企業永續績效與法規合規，強化長期合作黏著度與品牌影響力。

[TOP ^](#)

主要業務項目：

主營高純度有機金屬前驅物產品之研發、製造及銷售，可提供從材料的合成、純化、分裝、分析、倉儲、運輸，乃至於鋼瓶回收清洗、安全操作教育訓練等全方位的服務。

公司所屬產業之上、中、下游結構圖：



化學原料供應商



提供製造前驅物所需的基礎化學品。

前驅物製造商

將上游原料轉化為高純度、符合特定規格的半導體前驅物，供應給晶圓代工廠。

積體電路晶片、平面顯示器、太陽能電池等

使用前驅物在晶圓上製造積體電路，是整個產業鏈的終端應用方。

產品名稱	產品圖示及介紹	重要用途或功能	最近一年度營收金額(千元)	佔總營收比重(%)
ALD 前驅物材料商品銷售		原子層沉積 (ALD) 製程，形成具功能性的金屬、氧化物或氮化物薄膜。	57,219	93.33%
勞務收入		鋼瓶及閥件清潔及漏氣測試	3,315	5.41%
其他		其他	774	1.26%
合計數			61,308	100.00%

[TOP ^](#)

最近五年度簡明損益表及申請年度截至最近月份止之自結損益表

單位：新臺幣千元

項目	年度	109年	110年	111年	112年	113年	114年截至11月份止(自結數)(註)
營業收入		44,182	60,502	54,618	51,073	61,308	120,587
營業毛利		5,144	6,448	10,671	3,333	(163)	15,804
毛利率(%)		11.64	10.66	19.54	6.53	(0.27)	13.11
營業損益		(38,727)	(57,050)	(73,608)	(98,514)	(107,449)	(103,616)
營業外收入		8,507	5,678	12,687	25,058	9,643	9,070
營業外支出		(3,675)	(3,811)	(7,247)	(5,719)	(5,769)	(17,368)
稅前損益		(33,895)	(55,183)	(68,168)	(79,175)	(103,575)	(111,914)
稅後損益		(33,895)	(55,183)	(68,168)	(79,175)	(103,575)	(111,914)
每股盈餘(元)		(1.10)	(1.57)	(1.64)	(1.67)	(2.05)	(1.37)

修訂日期：114年12月

發放	現金股利(元)	-	-	-	-	-
	股票股利(資本公積轉增資)(元)	-	-	-	-	-
	股票股利(盈餘轉增資)(元)	-	-	-	-	-

(註)係自結數字，未經會計師查核簽證，因此可能與會計師查核結果存有差異，請投資人於參考時審慎評估。

年度		109 年度	110 年度	111 年度	112 年度	113 年度
項目						
流動資產		76,243	99,961	184,101	162,803	346,213
按攤銷後成本衡量之金融產品-非流動		-	-	-	5,934	5,960
不動產、廠房及設備		203,214	185,657	188,442	181,795	188,534
使用權資產		42,904	101,581	102,463	110,524	102,701
存出保證金		462	1,569	5,640	-	-
預付設備款		-	-	-	9,328	11,209
無形資產		-	-	-	-	-
其他非流動資產		7,093	11,486	3,673	6,070	5,830
資產總額		329,916	400,253	484,319	476,454	660,447
流動負債	分配前	81,314	102,387	106,929	90,194	98,587
	分配後	81,314	102,387	106,929	90,194	98,587
非流動負債		119,718	119,718	181,712	168,446	153,991
負債總額	分配前	201,032	284,099	275,375	244,185	241,887
	分配後	201,032	284,099	275,375	244,185	241,887
歸屬於母公司業主之權益		-	-	-	-	-
股本		337,919	337,919	366,221	466,220	500,000
資本公積	分配前	122,183	136,334	197,292	266,013	467,939
	分配後	122,183	136,334	197,292	266,013	467,939
保留盈餘	分配前	(331,218)	(386,401)	(454,569)	(533,744)	(637,319)
	分配後	(331,218)	(386,401)	(454,569)	(533,744)	(637,319)
其他權益		-	-	-	-	-
庫藏股票		-	-	-	-	-
非控制權益		-	-	-	-	-
股東權益總額	分配前	128,884	116,154	208,944	232,269	418,560
	分配後	128,884	116,154	208,944	232,269	418,560

TOP ^

修訂日期：114 年 12 月

最近三年度財務比率				
		年 度		
項 目		111 年	112 年	113 年
財 務 比 率	毛利率(%)	19.54	6.53	(0.27)
	流動比率(%)	172.17	180.5	351.18
	應收帳款天數(天)	100	85	78
	存貨週轉天數(天)	225	279	272
	負債比率(%)	56.86	51.25	36.62

[TOP ^](#)

投資人若欲查詢該公司更詳細之資料請連結至[公開資訊觀測站!!](#)